JEITA Japan Electronics & Information Technology Industries Association

JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会2015

（旧 鉛フリー化活動 成果報告会）

日 時　平成27年7月17日（金） 10:00～17:00 （受付開始 9:30～）
場 所　芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟（6階） 大講義室
主 催　一般社団法人 電子情報技術産業協会
企 画　JEITA／実装技術標準化専門委員会

Program

司 会　山本 克己 氏　テクノオフィス・ヤマモト

10:00～10:05	**主催者挨拶** 二宮 良次　JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 （株）東芝
10:05～10:10	**来賓挨拶** 清野 恵太 氏　経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 電子デバイス係長
10:10～10:30	**METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」の取り組み状況** 春日 壽夫 氏　基準認証イノベーション技術研究組合（IS-INOTEK）
10:30～11:00	**部品内蔵基板設計データフォーマット標準化の有効性** 松澤 浩彦 氏　（株）図研 EDA事業部
11:00～11:30	**フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC規格化状況** 西川 宏 氏　大阪大学 接合科学研究所 スマートプロセス研究センター 准教授
11:30～12:00	**「パワーデバイス実装の国際標準化」への取り組み** 岡本 正英 氏　JEITA 国プロ準備会副委員長 （株）日立製作所

休　憩　（昼食は各自にてお願い致します）

13:00～13:30	**「0201実装の現状と今後の課題」（1）部品関係** ― 世界最小 0201サイズ チップ積層セラミックコンデンサの実用化 ― 大森 長門 氏　（株）村田製作所 コンポーネント事業本部
13:30～14:00	**「0201実装の現状と今後の課題」（2）はんだ関係** ― 0201部品の実装に求められるはんだ材料特性 ― 高木 和順 氏　千住金属工業（株） ハンダテクニカルセンター
14:00～14:30	**「0201実装の現状と今後の課題」（3）実装機関係** ― 実践!! 0201部品の量産実装技術 ― 粟生 浩之 氏　富士機械製造（株） ハイテック事業本部
14:30～15:00	**EU-ELV指令の動向（高温はんだ、合金等の適用除外規定見直しについて）** 加藤 克久 氏　（株）デンソー

休　憩

15:15～15:40	**JEITAでの高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組みについて** 芹沢 弘二 氏　JEITA 高温鉛入りはんだ代替金属材料WG主査 千住金属工業（株）
15:40～16:10	**JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の市場動向と課題** 萩尾 浩一 氏　（株）ニホンゲンマ
16:10～16:30	**SAC系はんだ接合寿命予測に関する苅谷モデルの実証実験（その3）** 山本 剛 氏　富士通アドバンストテクノロジ（株）
16:30～17:00	**Sn-Ag-Cu合金における疲労き裂進展挙動の結晶方位依存性** 苅谷 義治 氏　芝浦工業大学 工学部 材料工学科 教授

プログラムの内容につきましては、変更となる場合もありますので、予めご承知おきください。

JEITA

環境調和型先端実装技術　成果報告会2015

ご 挨 拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年から実装技術の鉛フリー化活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会』として、この一年間の先端的な実装技術の検討結果および鉛フリー化関連活動成果を、ご報告させていただきます。

今回は、METIプロジェクト「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」をはじめ、鉛フリー化関連では、フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC規格化状況、高温はんだ・合金等の適用除外規定見直しに関するEU-ELV指令の動向、高温はんだの鉛フリー化、JEITAプロジェクト「第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化」の結果を受けた第2世代低銀系ソルダペースト標準品の市場動向等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

他にも、ウェアラブル機器の拡大に伴い、重要性が増してきています0201実装において、部品、はんだ、実装機それぞれの視点からの現状と今後の課題についての報告、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動として、現在主流になっている錫-銀-銅系鉛フリーはんだの接合寿命予測等についての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA　実装技術標準化専門委員会　委員長　二宮 良次〔(株)東芝〕

参加要領

■日　　時　平成２７年７月１７日（金）１０：００～１７：００（受付開始9:30～）

■場　　所　芝浦工業大学　豊洲キャンパス交流棟（６階）　大講義室
東京都江東区豊洲3-7-5
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

■申 込 方 法　参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込みください。
登録完了後、登録E-mailアドレスに確認メールをお送り致します。
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。
申込書は以下リンクからダウンロードください。
http://home.jeita.or.jp/tss/2015kankyochowa_EntrySheet.xls
（本状下部の申込書に記入の上、FAXでお送り頂いても結構です。）

■申 込 期 限　平成２７年７月１０日（金）必着

■定　　員　１００名
（定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込みください。）

■参　加　費　会員　１０，０００円(税込)
一般　１５，０００円(税込)

■配 布 資 料　成果報告書（当日配布致します）

■お問合せ先　一般社団法人 電子情報技術産業協会
知的基盤部 標準Ｇ（岩渕・塩川・澤田）
TEL:03-5218-1059　FAX:03-5218-1078
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

会場へのアクセス

最寄駅のご案内：東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分
JR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分

(一社)電子情報技術産業協会／知的基盤部行
FAX:03-5218-1078　E-mail:tsc4@jeita.or.jp

「環境調和型先端実装技術　成果報告会2015」参加申込書

貴　社　名		会 員 確 認	会　員　・　一　般（非会員） （いずれかに○を付けてください。）

※ 会員／一般（非会員）の確認は、JEITA会員一覧＜http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi＞でお願い致します。

参加者氏名		所属役職名	
連絡先住所	（〒　　）		
TEL番号		FAX番号	
E－mail			

※ 複数名の参加申込みの場合は、以下にご記入ください。（受講票と請求書は参加者ごとに個別にお送り致します。）

参加者氏名		所属役職名	
連絡先住所	（〒　　）		
TEL番号		FAX番号	
E－mail			